

# LMP シンポジウム 2009

## 「レーザー加工の新プロセス展開と性能評価、規格化の最近のトレンド」

開催日時：平成 21 年 2 月 9 日(月)～10 日(火)

開催場所：建築会館 1 階ホール(東京・三田)

主 催

社団法人 日本溶接協会

企 画

レーザー加工技術研究委員会(LMP 委員会)

(Laser Material Processing Committee)

協 賛

- |          |            |                |
|----------|------------|----------------|
| ◆(社)溶接学会 | ◆(社)日本金属学会 | ◆(社)レーザー学会     |
| ◆(社)高温学会 | ◆(社)日本鉄鋼協会 | ◆(社)日本チタン協会    |
| ◆ステンレス協会 | ◆(社)自動車技術会 | ◆(社)軽金属溶接構造協会  |
| ◆レーザー協会  | ◆レーザー加工学会  | ◆中部レーザー応用技術研究会 |
| ◆産報出版(株) |            | (順不同、依頼中含む)    |

### 【 開 催 主 旨 】

近年のレーザー加工機器のめざましい発展に伴い、レーザー溶接をはじめとするレーザー加工技術の実用化が着実に進んでいます。日本溶接協会 LMP 委員会では、レーザー加工の実用化を念頭に、高出力のレーザー発振器やレーザー加工に関する最新の話題、産業応用の現状と今後の展開と課題等について、2001 年より年 1 回のレーザー加工に関する LMP シンポジウムを開催して参りました。

今年度は、レーザー発振器、周辺装置等が目覚しく進歩していく中で、これらを有効に使いこなす新しいプロセス技術の展開とその課題、またレーザー加工によって得られた製品を安全により幅広く利用してもらうための評価技術と規格化のトレンドをシンポジウムの主題として取り上げました。これらの最新情報と技術動向に関して、開発側である加工機器メーカーおよび利用・応用側である重工業、自動車、ジョブショップなどの産業界から、さらにその複雑な加工現象に関しては大学・研究機関から、それぞれ著名な専門家にご講演をお願いしております。また、LMP 委員会の大きな役割の一つである規格化に関しても、当委員会の専門家から紹介させていただくと共に、トピックスとして、現在進められている鋼構造物へのレーザー溶接適用に関する国家プロジェクトの概要とそこにおける規格化の役割に関して、プロジェクト関係者を招いてご講演も企画致しました。

この貴重な機会をご利用頂き、益々発展するレーザー加工の動向をより正確に把握され、さらなる新技術開発の一助として役立てて頂ければと思い、ここにご案内申し上げます。

## 〔 プ ロ グ ラ ム 〕

第1日目:平成21年2月9日(月)

10:30～10:35	開会の挨拶	LMP 委員会委員長 杓名 宗春 氏
<b>セッション1【自動車産業におけるレーザ溶接1】</b>		司会:JFE スチール(株) 木谷 靖 氏
10:35～11:20	自動車産業におけるリモート溶接の現状	Rofin-Sinar Laser GmbH Markus Ruetering(マックス・ルーティング)氏
11:20～12:05	自動車の軽量化に役立つ新応用	Soutec Soudronic AG ダニエル・ヴェンク氏 (株)スーテック・ジャパン 石原 弘一 氏
12:05～13:00	昼 食 休 憩(昼食は各自でご用意下さい)	
<b>セッション2【自動車産業におけるレーザ溶接2】</b>		司会:(独)物質・材料研究機構 塚本 進 氏
13:00～13:45	レーザリモート溶接における誘起プラズマ挙動とその影響	大阪大学 片山 聖二 氏
13:45～14:30	kW級半導体レーザ発振機の開発と溶接特性	住友金属工業(株) 泰山 正則 氏
14:30～14:45	休 憩	
<b>セッション3【微細・除去加工1】</b>		司会:(株)IHI 山岡 弘人 氏
14:45～15:30	シングルモードファイバーレーザの可能性	(株)レーザックス 荒谷 雄 氏
15:30～16:15	電子部品へのレーザ接合の適用	ミヤチテクノス(株) 加瀬 純平 氏
16:15～17:00	レーザクリーニングの適用例	サマック(株) 本村 孔作 氏

第2日目:平成21年2月10日(火)

<b>セッション4【微細・除去加工2】</b>		司会:日産自動車(株) 坂元 宏規 氏
10:00～10:45	レーザによる電子部品の精密加工	オムロンレーザフロント(株) 中村 強 氏
10:45～11:30	ジョブショップにおける微細加工の適用事例	東成エレクトロビーム(株) 高橋 邦朋 氏
11:30～12:30	昼 食 休 憩(昼食は各自でご用意下さい)	
<b>セッション5【厚板レーザ加工の実用化、継手性能評価】</b>		司会:日立造船(株) 北側 彰一 氏
12:30～13:15	レーザ加工の最前線	三菱重工業(株) 石出 孝 氏
13:15～14:00	大型構造物へのレーザ溶接適用に向けた継手および部材の性能 確証	(株)IHI 猪瀬 幸太郎 氏
14:00～14:45	厚鋼板レーザ溶接継手の靱性および疲労特性評価	JFE スチール(株) 半田 恒久 氏
14:45～15:00	休 憩	
<b>セッション6【レーザ加工に関する国家プロジェクトと国際規格】</b>		司会:宮城工業高等専門学校 柴田 公博 氏
15:00～15:30	NEDOプロジェクト「鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤技 術研究開発」におけるレーザ溶接の取り組み	JFE スチール(株) 安田 功一 氏
15:30～15:55	レーザ加工関連ISO規格の最近の動向	光産業創成大学院大学 杓名 宗春 氏
15:55～16:20	レーザ溶接部の硬さ試験に関するISO規格の紹介	JFE スチール(株) 木谷 靖 氏
16:20～16:25	閉会の挨拶	LMP委員会副委員長 片山 聖二 氏

※講師及びスケジュールについては、やむを得ない事情により変更になる場合があります。

最新情報はホームページにてご確認下さい。 <http://www.jwes.or.jp/lmp/>

## 〔 開催要領 〕

### 1. 日 時

平成21年2月 9日(月) 10:30~17:00

平成21年2月10日(火) 10:00~16:25

### 2. 定 員

180名(定員になり次第、締切りとさせていただきます)

### 3. 参加料

(テキスト代・消費税を含む)

参加日数	会 員※	非会員
2日間	15,000円	25,000円
1日のみ	10,000円	15,000円

※会員とはLMP委員会会員会社(参加申込書参照)または、  
日本溶接協会団体会員会社 <http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp> 参照です。

### 4. 申込要領ほか

- ・添付の参加申込書にご記入の上、FAXにて下記宛先までご送付下さい。
- ・参加料は次の方法でご送金下さい。(銀行振込手数料は、御社にてご負担下さい)

**銀行振込： 三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No. 146921 (社)日本溶接協会**

(原則として、銀行口座への振込みをもって領収に代えさせていただきますのでご了承下さい)

- ・振込み後の参加料は返却致しません。欠席の場合は、代理出席をお願い致します。
- ・申込受付後、FAXにて受講券をお送り致します。当日必ずご持参下さい。
- ・テキストは、当日会場受付でお渡し致します。
- ・昼食は各自でご用意願います。

### 5. 講習会事務局

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-11 産報佐久間ビル 9階

(社)日本溶接協会 業務部 内海(ウチウミ)

TEL : 03-3257-1524 FAX : 03-3255-5196

### 6. 会場

会 場：建築会館 1階ホール

住 所：〒108-8414 東京都港区芝 5-26-20

アクセス：JR 田町駅、都営地下鉄三田駅  
(浅草線・三田線) 徒歩3分



FAX : 03-3255-5196

日本溶接協会 内海宛

**LMP シンポジウム 2009**  
**「レーザ加工の新ブレイス展開と性能評価、規格化の最近のトレンド」 参加申込書**

1	フリガナ		
	氏名	(姓)	(名)
勤務先 (会社名・部署)			
同上所在地	〒		
	TEL :	FAX :	
E-mail			
会員・非会員	会 員 ・ 非会員		
参加日数	2日間 ・ 2/9(月)のみ ・ 2/10(火)のみ		
<input type="checkbox"/> 次回シンポジウムの案内を希望される方はチェックを入れて下さい。郵送、メール等でご案内致します。			

2	フリガナ		
	氏名	(姓)	(名)
勤務先 (会社名・部署)			
同上所在地	〒		
	TEL :	FAX :	
E-mail			
会員・非会員	会 員 ・ 非会員		
参加日数	2日間 ・ 2/9(月)のみ ・ 2/10(火)のみ		
<input type="checkbox"/> 次回シンポジウムの案内を希望される方はチェックを入れて下さい。郵送、メール等でご案内致します。			

○記載頂いた個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に則り、弊協会が定めた「個人情報保護方針」に従って管理致します。詳細については日本溶接協会HP <http://www.jwes.or.jp/> をご覧下さい。

参加料 : (テキスト代・消費税を含みます)

参加日数	会 員※	非会員
2 日 間	15,000円	25,000円
1日のみ	10,000円	15,000円

※会員とは LMP 委員会会員会社または、日本溶接協会団体会員会社 <http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp> 参照です。

振込予定日 : 平成 年 月 日頃

振込金額 : ¥ \_\_\_\_\_

**【※LMP 委員会会員会社】**  
(株)IHI、岩谷産業(株)、OBARA(株)、  
小池酸素工業(株)、日産自動車(株)、  
住友重機械メカトロニクス(株)、  
(株)ダイヘン、日酸 TANAKA(株)、  
JFE スチール(株)、(株)レーザックス、  
日本ウエルディング・ロッド(株)、  
日立造船(株)、三菱重工業(株)、  
ミヤチテクノス(株)、新日本製鐵(株)  
パナソニック溶接システム(株)、  
オムロンレーザーフロント(株)、  
日立 GE ニュークリア・エナジー(株)  
(株)最新レーザ技術研究センター

・参加料は次の方法でご送金下さい。(銀行振込手数料は、御社にてご負担下さい)

**銀行振込 : 三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No. 146921 (社)日本溶接協会**

(原則として、銀行口座への振込みをもって領収に代えさせていただきますのでご了承下さい)